

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

VERSION CORRIGÉE

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
10 février 2022 (10.02.2022)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2022/028783 A9

(51) Classification internationale des brevets :

H01Q 1/22 (2006.01) *G06K 19/077* (2006.01)

(71) Déposant : **SMART PACKAGING SOLUTIONS**

[FR/FR] ; 85 AVENUE DE LA PLAINE, ZI DE ROUSSET, 13790 ROUSSET (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2021/068024

(72) Inventeurs : **DAUPHIN, François** ; c/o SMART PACKAGING SOLUTIONS, 85 AVENUE DE LA PLAINE, ZI DE ROUSSET, 13790 ROUSSET (FR). **CALVAS, Bernard** ; c/o SMART PACKAGING SOLUTIONS, 85 AVENUE DE LA PLAINE, ZI DE ROUSSET, 13790 ROUSSET (FR). **MEAR, Benjamin** ; c/o SMART PACKAGING SOLUTIONS, 85 AVENUE DE LA PLAINE, ZI DE ROUSSET, 13790 ROUSSET (FR).

(22) Date de dépôt international :

30 juin 2021 (30.06.2021)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

2008259 04 août 2020 (04.08.2020) FR

(54) Title: ELECTRONIC MODULE FOR A CARD CONTAINING AT LEAST ONE ANTENNA AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) Titre : MODULE ÉLECTRONIQUE POUR CARTE CONTENANT AU MOINS UNE ANTENNE ET SON PROCÉDE DE FABRICATION

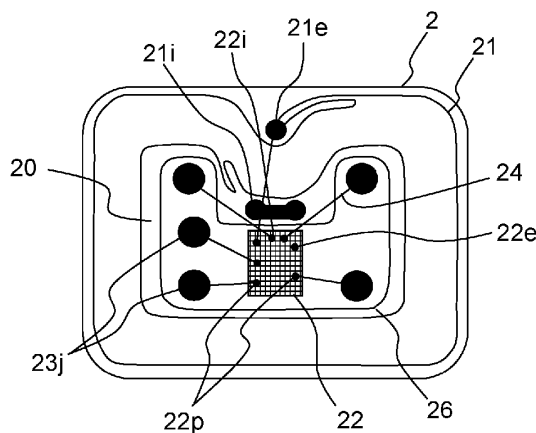


FIG. 1

(57) Abstract: An electronic module (2) and the manufacturing method thereof, the electronic module comprising a substrate (20) on which one or more electrically conductive tracks (21) are arranged, at least one integrated circuit (22) comprising several bond pads (22p), characterised in that it comprises: - at least one intermediate bond pad (25) located on at least one face of the substrate (20), - the intermediate bond pad (25) is connected at least - at a first point, to the electrically conductive tracks (21) or to a connection well at the substrate (20), by means of a first bonding wire (241), and - at a second point, to at least one pad of the integrated circuit (22), by means of a second bonding wire (242).

(57) Abrégé : Module électronique (2) et son procédé de fabrication, le module électronique comportant un substrat (20) sur lequel sont disposées une ou plusieurs pistes électriquement conductrices (21), au moins un circuit intégré (22) comprenant plusieurs plots de connexion (22p), caractérisé en ce qu'il comporte: - Au moins un plot intermédiaire de connexion (25) situé sur au moins une face dudit substrat (20), - Ledit plot intermédiaire de connexion (25) est connecté au moins - En un premier point, auxdites pistes électriquement conductrices (21) ou à un puits de liaison au niveau du substrat (20), au moyen d'un premier fil de connexion (241), et - En un deuxième

[Suite sur la page suivante]

(74) **Mandataire : MARKS & CLERK FRANCE** ; Immeuble
"Visium", 22, avenue Aristide Briand, 94117 ARCUEIL
Cedex (FR).

(81) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible*) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(48) **Date de publication de la présente version corrigée:**
17 mars 2022 (17.03.2022)

(15) **Renseignements relatifs à la correction:**
voir la Notice du 17 mars 2022 (17.03.2022)